

指導教授

簡禎富

教授

參與學生

u870848 蔡名峰

u870852 謝佳宏

摘要

在晶圓製造的過程中，往往需要經過上百道的加工製造，在晶圓通過機台時會以人工或自動化的方法來蒐集其參數資料並且分析導致不良品產生的原因，這些大量的歷史資料可提供給工程師來判斷晶圓壞點的原因，然而有時這些參數資料並不是那麼的方便使用，例如：由人工或電腦所蒐集到的壞點晶圓資料可能有好幾百種，可是導致壞點的因素可能屈指可數；因此，經驗不足或是新進的工程師在接收晶圓資料可能需要花費很長久的時間去了解損壞原因，繼而下達改善命令。但是這對講究品質與交期的半導體產業是絕對無法容許的情況；因此本專題主要在探討並建構一晶圓辨識軟體雛形，來針對這些參數資料作有效率的分析管理，並且提供一個容易瞭解的介面，幫助工程師可以快速分析問題發生的原因，進而達到可以提昇產品的良率與故障排除的目的。

回目錄